

수업계획서

2018학년도 제 1학기

경기대학교

| 교과목명 | 학수 코드 | 이수 구분 | 학점 | 시 수 | 학 년 | 과목 번호 | 요일 및 강의시간 | 담당교수 | E-mail 및 연락처 |
|---|----------|----------|----|--------|--------|----------|--------------|------|--------------|
| 전자 패키징 | X | 전공 | 3 | 3 | | X | 없음 | 선용빈 | |
| 교과목해설 | | | | | | | | | |
| <p>이동통신 기기의 발달과 더불어 첨단산업 전자 부품과 시스템 패키징에 대하여 fab 부문의 PI 공정과 배선의 재배열 공정에서부터 Sub-system 장착까지 전반을 다룬다. 전자 패키징 기술의 경향에 대한 설명을 통하여 효율적인 공정 관리 개념과 표준화, 그리고 신뢰성에 미치는 제품의 packaging design시 고려해야 할 사항 등을 다룬다.</p> | | | | | | | | | |
| 핵심역량 | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. (50%) 패키지의 경박단소화와 성능 향상에 대한 이해 2. (30%) 패키징 소재와 공정에 대한 이해 3. (20%) 각종 시험 방법과 신뢰성 확보에 대한 이해 | | | | | | | | | |
| 강좌목표 | | | | | | | | | |
| <p>디바이스의 경박단소화와 성능 향상을 구현할 수 있는 재료와 공정을 설계할 수 있으며, 구현된 부품의 신뢰성을 평가하는 시험 방법과 표준에 대해 체계적인 지식을 습득함으로써 현장 경험으로 얻어진 결과를 이론적으로 이해할 수 있어 생산성 향상에 기여할 수 있도록 한다.</p> | | | | | | | | | |
| 강의방법 | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 강의형태 : 이론중심 (<input type="radio"/>) 이론과 실습중심 (<input type="checkbox"/>) 실험/실습중심 (<input type="checkbox"/>) • 수업방식 : 강의식 (<input type="radio"/>) 세미나식 (<input type="checkbox"/>) 토론식 (<input type="checkbox"/>) 질의/응답 (<input type="checkbox"/>) Team Teaching (<input type="checkbox"/>) 워크숍 (<input type="checkbox"/>) 발표 (<input type="checkbox"/>) 실험/실습 (<input type="checkbox"/>) 실기 (<input type="checkbox"/>) 이러닝 (<input type="radio"/>) 기타 (<input type="checkbox"/>) • 교육용 기자재 : OHP (<input type="checkbox"/>) Slide (<input type="checkbox"/>) Video (<input type="checkbox"/>) LDP (<input type="checkbox"/>) Audio (<input type="checkbox"/>) 컴퓨터 (<input type="radio"/>) 모형물 (<input type="checkbox"/>) 유인물 (<input type="checkbox"/>) 기타 (<input type="checkbox"/>) | | | | | | | | | |

| 강좌 내용 | | | | |
|-------------|--|----|-------|-----|
| 주 | 교수 내용 | 방법 | 관련 자료 | 과제물 |
| 1 | 강의 개요 및 전자 패키지 타입 | 강의 | 참고자료 | |
| 2 | Backgrinding~Sawing | 강의 | 참고자료 | |
| 3 | Die attach~Wire bonding | 강의 | 참고자료 | |
| 4 | Molding~Trim & Forming | 강의 | 참고자료 | |
| 5 | Surface Mount Technology | 강의 | 참고자료 | |
| 6 | Printed Circuit Board | 강의 | 참고자료 | |
| 7 | WLP & Interposer | 강의 | 참고자료 | |
| 8 | 도금 | 강의 | 참고자료 | |
| 9 | 분석 및 신뢰성 테스트 | 강의 | 참고자료 | |
| 10 | Packaging Advanced | 강의 | 참고자료 | |
| 주요교재 및 참고자료 | | | | |
| 구분 | 자료명 | | | |
| 교재 | 없음 | | | |
| 참고자료 | 1. Plastic-Encapsulated Microelectronics, M.G. Pecht, Wiley, 1995 2. Fundamentals of Microsystems Packaging, R. Tumala, McGraw-Hill, 2001 | | | |